







Таблица 1

Условное обозначение отб	Диаметр отб, мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отб
	0,8±0,05	1,6	Да	41
	1±0,05	1,6	Да	24
	1,2±0,05	2,5	Да	6
	1,5±0,05	2,6	Да	18
	2,4 ^{+0,25}	3,0	Да	2
	2,8 ^{+0,25}	-	Да	4

1. Общие допуски формы и расположения – 30893.2-2002 – И.
2. Шаг координатной сетки 0,25мм ГОСТ Р 51040-97
3. Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 – 2.
5. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
6. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости – 1.
7. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не более 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоём ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
8. Контроль функциональный ручным методом по ГОСТ 23752-1-92.
9. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

					ИУЧ.11.03.03.21.7.3.14.002						
									Лит	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	УМЗ4 на дипольных транзисторах Плата печатная						2,5:
Разраб	Круглов В. С.										
Проб	Селиванов К.В.										
Т контр											
Н контр					Стеклоэлектромол FR4-T gl 35 IPC-4101 / ZI				Лист	Листов	1
Чтл									ИТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУА Группа ИУА-73Б		